



kingston.com/emcp

eMCP

Alan açısından kısıtlı mobil, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve gömülü uygulamalar için güç açısından verimli mükemmel entegre veri saklama çözümü

Kingston, JEDEC standardına uygun bir dizi eMCP bileşeni sunmaktadır. eMCP, Gömülü Multimedya Kart (e-MMC) veri saklama çözümünü ve Düşük Güç Çift Veri Hızı (Low-Power Double Data Rate - LPDDR) DRAM'i, küçük boyutlara sahip bir Çoklu Yonga Paketinde (Multi-Chip Package - MCP) bir araya getirmektedir. Bu çözüm, genel boyutu azaltarak daha fazla entegrasyon olanağı sağlar. eMCP, akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar ve çeşitli "Nesnelerin İnterneti" (IoT) cihazları gibi kısıtlı alana sahip sistemler için ideal bir birleşik veri saklama ve bellek bileşenidir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Endüstri standardı bir eMMC arayüzü ile tasarım ve ürün sürdürülebilirliğini basitleştiren yönetimli NAND flash çözümü. Bu durum, tasarım karmaşıklığını ve uygunluk onaylama süresini önemli ölçüde azaltır.
- Yüksek düzeyde entegre bellek ve veri saklama birlikteliği, sistem tasarımında alanı azaltarak eMCP'yi küçük form faktörlü uygulamalar için ideal bir çözüm haline getirir.
- Düşük Güç DRAM, toplam güç tüketimini azaltarak eMCP'yi giyilebilir cihazlar ve mobil IoT ürünleri gibi pille çalışan birçok uygulama için en uygun çözüm haline getirir.
- Bileşen sayısındaki azalma ile daha az Malzeme Listesi (Bill of Material) karmaşıklığı.
- Uygulamanızın performans, güç ve kullanım ömrüne yönelik gereksinimlerine en iyi şekilde uyacak birden fazla yazılım yapılandırması mevcuttur.

PAZAR SEGMENTLERİ



Akıllı Telefonlar ve Tabletler



Giyilebilir Cihazlar



Yapay Zeka (AI) Hızlandırıcılar



IoT

eMCP PARÇA NUMARALARI VE ÖZELLİKLERİ

LPDDR3 tabanlı eMCP

Parça Numarası	Kapasite		Standart		Paket	FBGA	Çalışma Sıcaklığı
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C ~ +85°C
08EM08-N3GML36	8	8	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C ~ +85°C
16EM08-N3GTB29	16	8	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C ~ +85°C
16EM16-N3GTB29	16	16	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C ~ +85°C
32EM16-N3GTX29	32	16	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C ~ +85°C
32EM32-N3HTX29	32	32	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,1	221	-25°C ~ +85°C
64EM32-N3HTX29	64	32	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,1	221	-25°C ~ +85°C

LPDDR4x based eMCP

Parça Numarası	Kapasite		Standart		Paket	FBGA	Çalışma Sıcaklığı
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM08-M4EM627	4	8	5.1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	149	-25°C ~ +85°C
16EM16-M4CTB29	16	16	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C ~ +85°C
32EM16-M4CTX29	32	16	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C ~ +85°C
32EM32-M4DTX29	32	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C ~ +85°C
64EM32-M4DTX29	64	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C ~ +85°C
128EM32-M4DTX29	128	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,1	254	-25°C ~ +85°C

